

300mm全自动芯片背面保护胶带贴合机

## -3600F/12



## 概述

本全自动贴合机用于在研磨后的晶圆背面贴合晶片背面保护胶带 "Adwill LC胶带"。

可进行晶圆校准、Adwill LC胶带预切割、胶带贴合、离型膜撕除。

选配功能 •主机通信功能

(通信方式: SECS-I、HSMS标准; 软件: GEM标准)

•双晶盒供料

·晶圆ID读取器

适用的胶带 ·晶片背面保护胶带 "Adwill LC胶带"

## 规格

额定电源 供电电压 : AC200-230V ±10%

(AC190-253V)

频率 :50/60Hz 位相 :单相 功耗 : 6.0kW

气源 供气压力 : 0.5-0.8MPa

耗气量 :>150L/分钟(ANR) 真空供给 真空压力 :>-80kPa

适用的晶圆尺寸 200mm, 300mm

机台宽度(W):1,550mm 尺寸

设备纵深(D):1,950mm 设备高度(H): 1,800mm (凸出物及三色警示灯除外)

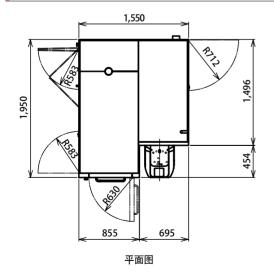
重量 1,500kg

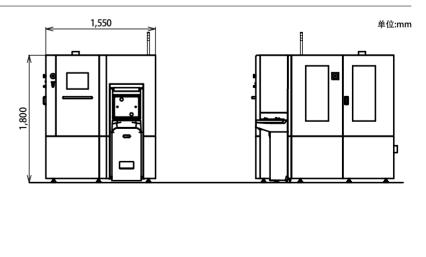
UPH 30片/小时(安装时间除外)

上述处理能力的依据条件如下。

晶圆 :未研磨300mm镜面晶圆 晶片背面保护胶带 :LC2850(40) from LINTEC

## 设备外形图





正面图 右侧面图

Contact: Advanced Materials Operations

LINTEC Corporation Linking your dreams

8th Fl., Bunkyo Garden Gate Tower, 1-1-1 Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan